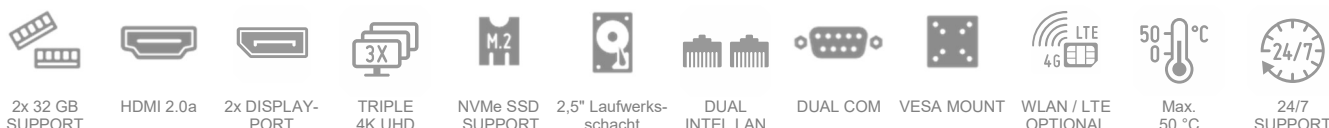


BAREBONE XPC slim DH470C

ROBUSTER 1,3-LITER SLIM PC UNTERSTÜTZT INTEL „COMET LAKE-S“ 10-KERN-PROZESSOREN UND DREI UHD DISPLAYS

Das Shuttle XPC slim Barebone DH470C mit H470 Chipsatz bringt die Performance von Intels 10. Generation der Core Desktop-Prozessoren (Codename "Comet Lake-S") mit Sockel LGA1200 ins kompakte 1,3-Liter Format. Es unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von drei Ultra HD Displays über HDMI 2.0a und 2x DisplayPort. Dual-Intel-Netzwerk, vier USB 3.2 Gen 2 und COM-Ports sind ebenfalls vorhanden. Sein flaches Metallgehäuse mit VESA-Halterung, die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und der zuverlässige Betrieb bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur machen das DH470C ideal für professionelle Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Digital Signage, POS, POI, Spielautomaten, Büro, Gesundheitswesen und Industrie.



SLIM DESIGN

■ Flaches 1,35-Liter Metallgehäuse, schwarz ■ Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH) ■ Mit VESA-Halterung (75/100 mm) ■ Unterstützt 24/7 Dauerbetrieb ■ Betriebstemperatur: 0-50 °C (nicht kondensierend)

BETRIEBSSYSTEM

■ Ein Betriebssystem ist nicht enthalten
■ Unterstützt Windows 10, Windows 11 und Linux (64-Bit)

PROZESSOR SUPPORT

■ Sockel LGA1200 unterstützt Intel Core Prozessoren der 10. Generation "Comet Lake-S": Core i9/i7/i5/i3, Pentium Gold und Celeron, max. 65W TDP ■ Heatpipe-Kühlsystem mit zwei Lüftern

GRAFIK

■ Integrierte Intel HD-Grafik, unterstützt 4K (Eigenschaften hängen vom Prozessortyp ab) ■ Unterstützt drei unabhängige Displays

CHIPSATZ

■ Intel H470 Chipsatz

SPEICHER SUPPORT

■ 2x 260-Pin SO-DIMM-Steckplatz ■ Unterstützt DDR4-2933 /2666 ■ max. 2x 32 GB

LAUFWERKE- SATA / M.2

■ 1x 2,5"-Schacht für SATA-Festplatte oder SSD ■ 1x M.2-2280M Steckplatz (unterstützt PCIe x4 NVMe oder SATA) ■ 1x M.2-2230E Steckplatz für optionales WLAN (WLN-M, WLN-M1)

ANSCHLÜSSE

■ HDMI 2.0a ■ 2x DisplayPort 1.2 ■ optional: VGA ■ 2x Audio (Mik+Out)
■ 4x USB 3.2 Gen2 ■ 4x USB 3.2 Gen1 (1x Typ-C) ■ 1x USB 2.0 intern
■ 2x Intel Gigabit LAN (RJ45, Intel i211) ■ 2x COM- (1x RS232/422/485)
■ Anschluss für externen Power-Button ■ "Always-On" Jumper

POWER SUPPLY

■ Externes 90W/19V Netzteil

OPTIONALES ZUBEHÖR

■ WLAN Modul (WLN-M, WLN-M1) ■ Standfuß (PS02) ■ VGA-Anschluss (PVG01) ■ Rackmount-Kit (PRM01) ■ Kabel für externen Power Button (CXP01) ■ Hutschienen-Montage-Kit (DIR01) ■ LTE-Kit (WWN03)

MODELLE DER DH4xx-SERIE

Produkt	Chip	Grafikausgänge	Displays	LAN	COM	Cardreader	DC-In	VESA Mount	UPC Code
DH410	H410	HDMI 2.0a + DP 1.2	max. 2	2x Intel 210	2	vorhanden	12V + 19V	enthalten	887993002385
DH410C	H410	HDMI 2.0a + DP 1.2	max. 2	2x Intel 210	2	—	12V + 19V	enthalten	887993003696
DH410S	H410	HDMI 1.4b + DP 1.2	max. 2	1x Realtek	—	vorhanden	19V	—	887993002460
DH470	H470	HDMI 2.0a + 2x DP 1.2	max. 3	2x Intel 210	2	vorhanden	19V	enthalten	887993002422
DH470C	H470	HDMI 2.0a + 2x DP 1.2	max. 3	2x Intel 211	2	—	19V	enthalten	887993003689 887993004938

LEISTUNGSMERKMALE



Robust, stilvoll und sehr klein

Man muss es selbst in der Hand gehalten haben, um zu merken, wie klein es wirklich ist. Das Stahlblechgehäuse verleiht diesem Slim-PC die nötige Stabilität für professionelle Anwendungen wie z.B. Digital Signage. Obwohl das Gehäuse für die gebotene Systemleistung mit nur 1,35 Litern sehr klein ist, wirkt der Aufbau nicht gedrängt, so dass die Installation leicht von der Hand geht. Dank seiner schlichten, stilvollen Optik wird es auch mancher stolzer Besitzer in seinem Büro oder zu Hause einsetzen.



Leise durch effizientes Heatpipe-Kühlsystem

Ein aktives Doppellüfter-Heatpipe-Kühlsystem gewährleistet größtmögliche Laufruhe und Systemstabilität.



Erweiterter Temperaturbereich und für Dauerbetrieb geeignet

Das Shuttle XPC slim Barebone DH470C ist offiziell für den 24-Stunden-Dauerbetrieb (24/7) freigegeben. Dank seiner niedrigen Verlustleistung und des fortschrittlichen Kühlsystems ist dieser PC besonders zuverlässig. Das eignet ihn ideal für Digital Signage und POI/POS-Anwendungen - auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C (nicht kondensierend). **Achtung:** Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40 °C werden SSD-Laufwerke empfohlen.



Unterstützt Intel® Core™

Prozessoren der 10. Generation

"Comet-Lake-S" ist der Codename von Intels 10. Generation der Intel® Core™ Prozessoren mit Sockel LGA1200, die 2020 zusammen mit der 400er-Chipsatzserie vorgestellt wurde. Intel Prozessoren der 10000er Serie haben bis zu 10 Kerne, 20 Threads und 20 MB Cache-Speicher und bieten eine ausgezeichnete Stabilität und Performance für einen breiten Anwendungsbereich.



Unterstützt drei UHD-Displays

Das DH470C bietet drei digitale Video-Ausgänge: ein HDMI 2.0a und drei DisplayPorts (DP), die jeweils ein 4K-Display mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung (2160p) und 60Hz Bildwiederholfrequenz unterstützen. Darüber hinaus ist ein optionaler D-Sub/VGA-Ausgang möglich.



Ein M.2-Slot für SSD-Karten

Der M.2-2280M Steckplatz unterstützt M.2 SSD Flashspeicherkarten mit NVMe/PCIe- oder SATA-Schnittstelle. Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit sein und können eine Länge von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260, 2280) haben.



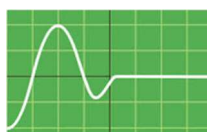
Dual Intel Gigabit Netzwerk

Das DH470C bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit Intel Netzwerk-Adaptoren - diese sind bekannt für exzellente Performance und Treiber-Kompatibilität und werden in manchen professionellen Bereichen bevorzugt eingesetzt.



VESA-Halter

Mit der mitgelieferten 75/100mm-VESA-Halterung kann das DH470C an einer Wand, an einer Armhalterung oder hinter einem Monitor montiert werden, was speziell in Industrie, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gefragt ist. Zahlreiche M3-Gewindeöffnungen im Gehäuse des PCs ermöglichen außerdem die Montage des DH470C an nahezu beliebigen Orten.



Einschalten nach Stromausfall

Die "Power-On after Power Fail"-Funktion im BIOS-Setup definiert, wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen (3) ausgeschaltet lassen (4) Einschalten über Netzwerk oder (5) Einschalten über Echtzeituhr (RTC). Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass das DH470C zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper JP2, dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.



Externer Power-Button per Remoteleitung

Für den Fall, dass das Gerät durch räumliche Gegebenheiten (z. B. einen Festeinbau) nicht durch den frontseitig angebrachten Power-Button eingeschaltet werden kann, ist es per separater Remoteleitung startbar. Hierzu verbindet man einen Taster über die entsprechenden Pins im Backpanel des PCs. (Rastermaß: 2.54 mm). Außerdem stellt dieser Anschluss eine Clear CMOS Funktion bereit und liefert eine +5V DC Spannung für externe Geräte.

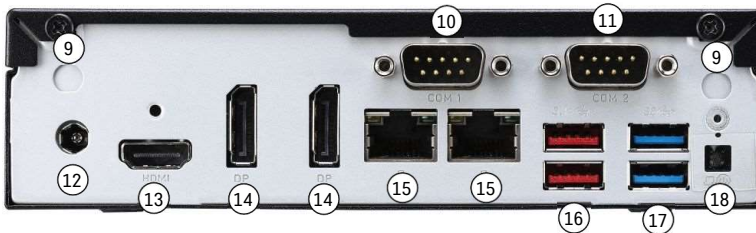
+5V voltage (2) (4) Power Button
Clear CMOS (1) (3) Ground

Vorder- und Rückansicht

Vorderseite



Rückseite



Rechts



Links



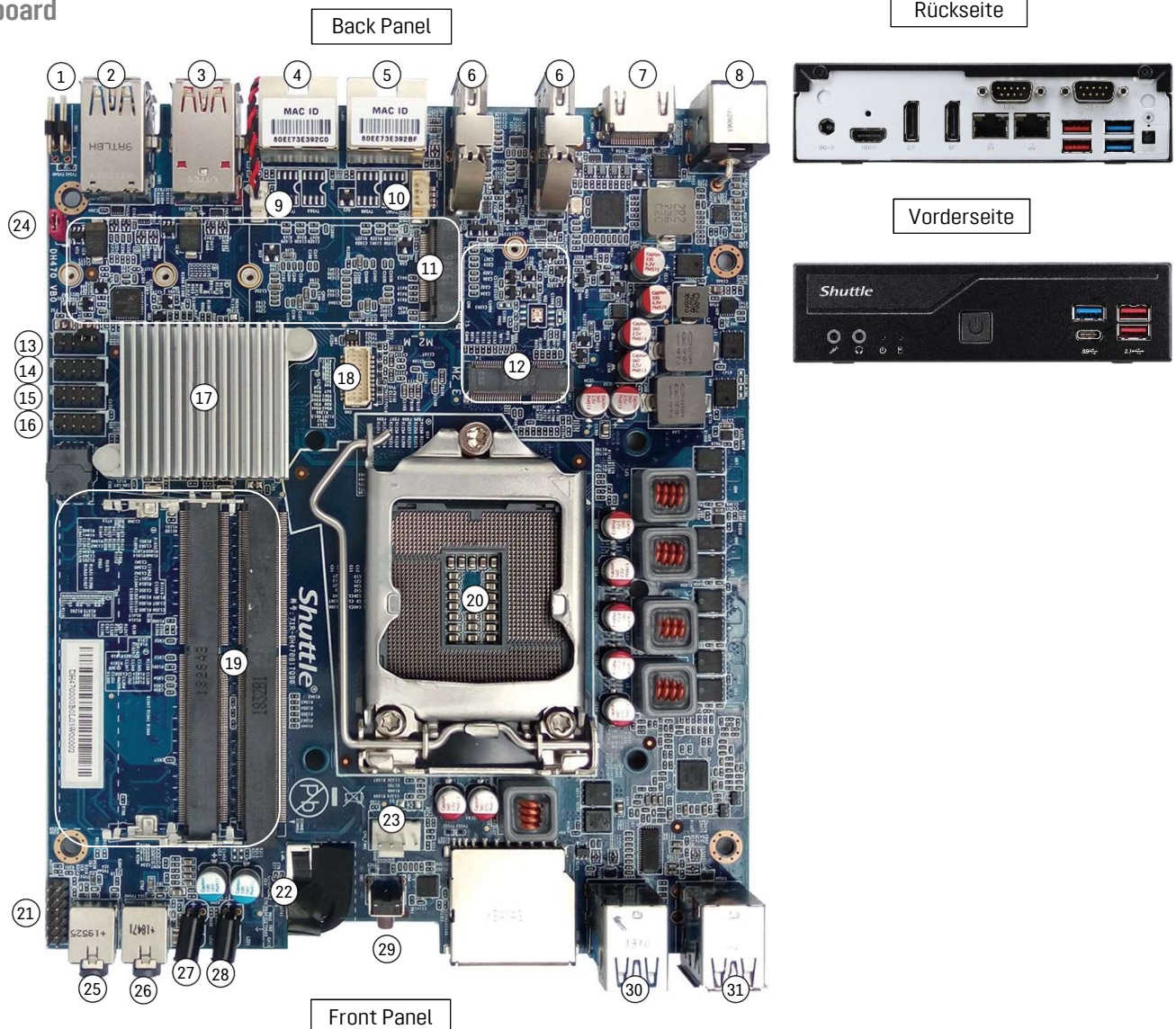
1. Mikrofon-Eingang
2. Kopfhörer-Ausgang
3. Betriebsanzeige-LED
4. Festplatten/SSD-LED
5. Ein-/Ausschalt-Button
6. 1x USB 3.2 Gen 1 Port
7. 1x USB 3.2 Gen 1 Port (1x Typ-C)
8. 2x USB 3.2 Gen 2 Port
9. 2x WLAN Perforation
10. COM 1 unterstützt RS232/RS422/RS485
11. COM 2 unterstützt RS232 (oder optionaler VGA-Port für ein analoges Display)
12. DC-Anschluss für das externe Netzteil
13. HDMI 2.0a Port
14. 2x DisplayPort 1.2
15. 2x RJ45 Gigabit LAN Port
16. 2x USB 3.2 Gen 2 Port
17. 2x USB 3.2 Gen 1 Port
18. Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V DC (4 Pins mit 2,54 mm Rastermaß)

19. Löcher mit M3-Gewinde
20. 2x Öffnung für das Kensington-Lock



21. VESA-Halterung (zwei Teile)

Mainboard



- | | |
|---|---|
| 1. 4-Pin-Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V DC-Spannung (2,54 mm Rastermaß) | 17. Intel H470 Chipsatz mit Kühlkörper |
| 2. 2x USB 3.2 Gen 1 Port (1x Typ-C) | 18. Onboard VGA Anschluss |
| 3. 2x USB 3.2 Gen 2 Port | 19. 2x SO-DIMM Speichersteckplatz |
| 4. RJ45 Gigabit LAN Port | 20. LGA1200 Prozessorsocket |
| 5. RJ45 Gigabit LAN Port | 21. Audio-Anschlüsse (optional) |
| 6. 2x DisplayPort 1.2 | 22. SATA v3.0 Anschluss |
| 7. HDMI 2.0a Port | 23. 4-Pin Anschluss für den Prozessorlüfter |
| 8. DC-Anschluss für externes Netzteil | 24. Always-Power-On Jumper |
| 9. Anschluss für CMOS-Batterie | 25. Mikrofon-Eingang |
| 10. Onboard USB-2.0-Anschluss (4-Pin) | 26. Kopfhörer-Ausgang |
| 11. M.2-2280M Steckplatz für SSD-Karte | 27. Betriebsanzeige-LED |
| 12. M2-2230E Steckplatz für WLAN-Karte | 28. Festplatten/SSD-LED |
| 13. Jumper zur Einstellung der COM 1/2 Hilfsspannung (0/5/12 V) | 29. Ein-/Ausschalt-Button |
| 14. Onboard COM 1 Port unterstützt RS232/RS422/RS485 | 30. 2x USB 3.2 Gen 1 Port |
| 15. Onboard COM 2 port unterstützt RS232 | 31. 2x USB 3.2 Gen 2 Port |
| 16. Debug-Anschluss (reserviert) | |

BENÖTIGTE KOMPONENTEN

Es werden nur wenige Komponenten benötigt, um einen lauffähigen Mini-PC zu erhalten:

Shuttle XPC slim Barebone DH470C



LGA1200 Prozessor

Intel Core Gen 10 "Comet-Lake-S"
Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium Gold oder Celeron
TDP max. 65 W



Speichermodule

Ein oder zwei Speichermodule:
DDR4-2666/2933 SO-DIMM
jeweils max. 32 GB



2,5" Laufwerk

Festplatte oder SSD im 2,5"-Format
(max. Bauhöhe: 12,5 mm)



M.2 SSD (optional)

M.2-2280/2260/2242
SSD-Modul (SATA or PCIe/NVMe)



Betriebssystem

Windows 10, Windows 11 oder Linux (nur 64-Bit)

OPTIONALES ZUBEHÖR VON SHUTTLE



VGA-Port-Adapter **PVG01**

Der Einbau von PVG01 ersetzt
eine serielle Schnittstelle
(COM-Port) im Backpanel.



Standfuß **PS02**

für den vertikalen Betrieb



WLAN-Kit

WLN-M / WLN-M1

Die M.2-2230-Karte
unterstützt IEEE 802.11
b/g/n/ac
Enthält 2 Antennen



Hutschienen-Kit **DIR01**

ermöglicht die Montage auf
einer Standard 35-mm-
Hutschiene



LTE Adapter Kit **WWN03**

ermöglicht die Installation
einer M.2-LTE-Karte und einer
nano SIM Karte (dabei wird der
2,5"-Schacht belegt)



Rackmount-Kit **PRM01**

2HE-Blende für Einbau von
zwei 1,3L-Shuttle-XPCs in
einen 19" Schrank



Kabel **CXP01**

Anschlusskabel für einen
externen Power-Button (ohne
Button)

Produktvergleich: 3xx-Serie versus 4xx-Serie

MODELL	DH310S	DH310V2	DH370	DH410S	DH410(C)	DH470(C)
PROZESSOR SUPPORT	Socket LGA1151v2, TDP max. 65 W Codename "Coffee Lake-S (Refresh)" – Gen 8 und 9			Socket LGA1200, TDP max. 65 W Codename "Comet Lake-S" – Gen 10		
CHIPSATZ	Intel H310	Intel H310	Intel H370	Intel H410	Intel H410	Intel H470
BETRIEBSSYSTEM	Windows 10/11 und Linux (64-Bit)			Windows 10/11 und Linux (64-Bit)		
MULTI-DISPLAY	max. 2	max. 2	max. 3	max. 2	max. 2	max. 3
RAM-SPEICHER	max. 2x 32 GB DDR4-2400/2666 SO-DIMM			max. 2x 32 GB DDR4-2666/2933 SO-DIMM		
2,5"-SCHACHT	1x 2,5" Laufwerksschacht, SATA-Anschluss max. Laufwerkshöhe: 12,5 mm			1x 2,5" Laufwerksschacht, SATA-Anschluss max. Laufwerkshöhe: 12,5 mm		
M.2 SSD SLOT	M.22280M			M.22280M		
WLAN SLOT	M.2-2230E			M.2-2230E		
BUTTONS / LEDS	Power-Button, Power LED, HDD LED			Power-Button, Power LED, HDD LED		
SD CARDREADER	Ja			Ja, jedoch nicht bei DH410C und DH470C		
GRAFIKPORTS	HDMI 1.4b DP 1.2	HDMI 2.0a DP 1.2	HDMI 2.0a 2x DP 1.2	HDMI 1.4b DP 1.2	HDMI 2.0a DP 1.2	HDMI 2.0a 2x DP 1.2
USB 3.2 GEN. 2	—	—	4	—	—	4
USB 3.2 GEN. 1	4 (1x Typ-C)	4	4	4 (1x Typ-C)	4	4 (1x Typ-C)
USB 2.0	4	4	—	4	4	—
COM PORTS	—	2	2	—	2	2
GIGABIT NETZWERK	Single LAN Realtek 8111H	Dual LAN 2x Intel 211	Dual LAN 2x Intel 211	Single LAN Realtek 8111H	Dual LAN 2x Intel 210	Dual LAN 2x Intel 210 o. 211
AUDIO	Mikrofon-Eingang, Line-Out (Realtek ALC662)			Mikrofon-Eingang, Line-Out (Realtek ALC662)		
OPTIONALES ZUBEHÖR	WLAN-Kit: WLN-M, WLN-M1 Standfuß: PS02 Rackmount-Kit: PRM01 VGA-Port-Adapter: PVG01 Power Button Kabel: CXP01 Hutschienen-Kit: DIR01			WLAN-Kit: WLN-M, WLN-M1 Standfuß: PS02 Rackmount-Kit: PRM01 VGA-Port-Adapter: PVG01 Power Button Kabel: CXP01 Hutschienen-Kit: DIR01 LTE-Kit: WWN03		
VESA-HALTER	optional PV04	mitgeliefert	mitgeliefert	optional PV04	mitgeliefert	mitgeliefert
NETZTEIL	90 W / 19 V			90 W / 19 V		
DC-IN 12V SUPPORT	—	Ja	—	—	Ja	—



*) Das DH370 hat keinen USB Typ-C Anschluss auf der Vorderseite, sondern ausschließlich Typ-A.

**) DH410C und DH470C haben keinen Cardreader eingebaut.

SHUTTLE XPC SLIM BAREBONE DH470C — SPEZIFIKATION

GEHÄUSE	Slim PC mit schwarzem Metallgehäuse Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH) = 1,35 Liter Gewicht: 1,3 kg netto und 2,1 kg brutto Zwei Öffnungen für Kensington Lock und zahlreiche M3-Gewindeöffnungen an beiden Gehäuseseiten.
NETZTEIL	Externes 90 W Netzteil (lüfterlos) Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz Ausgang: 19 V DC, 4,74 A, max. 90 W DC-Stecker: 5,5/2,5 mm (Außen/Innen-Durchmesser) Hinweis: Der DC-Eingang des Computers unterstützt eine externe Spannungsversorgung mit 19V±5% AC-Kabel: 3-polig, ca. 1,7 m lang, mit C5/C6 Kleeblatt-Steckverbindung zum Netzteil und CEE-7/7 Stecker mit Schutzkontakt (Typ E+F) für den Anschluss an die Steckdose
BETRIEBSSYSTEM	Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Es ist kompatibel mit Windows 10, Windows 11 und Linux (64 Bit).
PROZESSOR-UNTERSTÜTZUNG	Prozessor Sockel LGA1200 Unterstützt Intel Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium Gold und Celeron Prozessoren Unterstützt die zehnte Generation Intel Core Prozessoren mit dem Codenamen "Comet Lake-S" und 14 nm Technologie Unterstützt nur Prozessoren mit integrierter Grafikfunktion [10] Maximal unterstützte Prozessor-Verlustleistung (TDP) = 65 W. Bis zu 10 CPU-Kerne, 20 Threads und 20 MB L3-Cache Unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie. Der Prozessor integriert die Controller für PCI-Express und Speicher und die Grafikfunktion auf dem gleichen Halbleiter-Chip (Die Leistungsmerkmale hängen vom Prozessormodell ab.) Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com. Nicht kompatibel mit älteren Sockel-LGA1151(v2)-Prozessoren.
PROZESSOR-KÜHLUNG	Heatpipe-Prozessor-Kühlung mit zwei 60-mm-Lüftern auf der Gehäuseoberseite
MAINBOARD / CHIPSATZ	Mainboard im Shuttle-Format - spezielles Design für XPC Barebone DH470C Chipsatz/Southbridge: Intel® H470 Passive Chipsatz-Kühlung mit Kühlkörper Die Northbridge ist im Prozessor integriert. Mit Feststoffelektrolytkondensatoren (Solid Capacitors) - diese Kondensatoren sind hitzebeständiger und langlebiger.
BIOS	AMI BIOS, SPI-Interface, 16 MB Flash-EEPROM-Baustein Unterstützt Hardware-Überwachung und Watchdog-Funktion Unterstützt Firmware-TPM (fTPM) v2.0 [11] Unterstützt Booten vom externem Flashspeicher über USB Unterstützt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Unterstützt Neustart nach Stromausfall (Power-On-after-Power-Fail) [7]
SPEICHER-UNTERSTÜTZUNG	2x SO-DIMM-Steckplatz mit 260 Pins Unterstützt DDR4-2666/2933 (PC4-21300/23466) SDRAM mit 1,2 V Unterstützt Dual-Channel-Modus Unterstützt maximal 32 GB pro Steckplatz Gesamtkapazität maximal 64 GB Unterstützt unbuffered DIMM-Module (kein ECC oder registered) Hinweis: Die Taktrate beim Speicherzugriff hängt vom Prozessormodell ab. Prozessoren der Intel Core i9- und i7-Serie unterstützen DDR4-2933 Speichergeschwindigkeit, die anderen Modelle DDR4-2666.

INTEGRIERTE GRAFIKFUNKTION	Die Eigenschaften der integrierten Intel UHD Grafikfunktion hängen vom verwendeten Prozessortyp ab. Unterstützt DirectX 12, OpenGL 4.5 Der PC bietet drei Video-Ausgänge, die 1080p/60 und 2160p/60 unterstützen: - 1x HDMI v2.0a - 2x DisplayPort v1.2 Unterstützt 4K-Displays mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung Unterstützt drei unabhängige Displays über die integrierte Grafikfunktion Unterstützt Blu-ray (BD) Wiedergabe mit HDCP-Kopierschutz [9] Hardware Video Decoding/Encoding: H.264, H. 265 (8- und 10-Bit, Encoding mit QuickSync), VP9 (10-Bit VP9 kann nur dekodiert werden) DisplayPort und HDMI unterstützen Multikanal Digital Audio über das gleiche Kabel. Shared Memory max. 64 MB Optionaler analoger D-Sub/VGA-Videoausgang [4]
LAUFWERKSSCHACHT	1x 6,35 cm / 2,5" Laufwerksschacht für eine Festplatte oder ein SSD-Laufwerk mit SATA-Anschluss Laufwerkshöhe 12,5 mm (max.)
SATA-ANSCHLUSS	1x Serial-ATA III, 6 Gb/s (600 MB/s) Datentransferrate Mit Serial-ATA Stromanschluss (onboard)
M.2-2280M SSD -STECKPLATZ	Der M.2 2280M Steckplatz bietet folgende Schnittstellen: - PCI-Express Gen. 3.0 X4 unterstützt NVMe - SATA v3.0 (max. 6 Gbit/s) Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit sein und können eine Länge von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260, 2280) haben. Unterstützt M.2 SSDs mit SATA- oder PCI-Express-Schnittstelle
M.2-2230E-STECKPLATZ FÜR WLAN-KARTEN	Schnittstellen: PCI-Express Gen. 2.0 X1 und USB 2.0 Verwendete M.2-2230-Steckkarten müssen 22 mm breit und 30 mm lang sein (Typ 2230) Unterstützt WLAN-Erweiterungskarten (Optionales Shuttle-Zubehör: WLN-M / WLN-M1)
SOUNDFUNKTION	Audio Realtek® ALC 662 High-Definition Audio Zwei analoge 3,5mm Audio-Anschlüsse auf der Vorderseite: 1) 2-Kanal Line-out (Kopfhörer) 2) Mikrofon-Eingang Digitale Multikanal-Audio-Ausgabe über HDMI und DisplayPort
DUAL GIGABIT NETZWERK-CONTROLLER	Zwei RJ45 Netzwerkanschlüsse mit jeweils zwei Status-LEDs Verwendete Netzwerkchips: 2x Intel i211 Ethernet Controller (MAC+PHY) PCIe-Schnittstelle Unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate Unterstützt WAKE ON LAN (WOL) Unterstützt das Booten vom Netzwerk via Preboot eXecution Environment (PXE) Unterstützt den Teaming-Modus [5]
ANSCHLÜSSE VORDERSEITE	Mikrofon-Eingang Audio Line-out (Kopfhörer) 2x USB 3.2 Gen 2 Typ A (Rot) 1x USB 3.2 Gen 1 Typ A (Blau) 1x USB 3.2 Gen 1 Typ C Ein/Aus-Button Betriebsanzeige-LED (Blau) Festplatten-LED (Gelb)

ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE	1x HDMI 2.0a Anschluss [1] 2x DisplayPort 1.2 Anschluss (DP) [2] Optional: 1x D-Sub VGA Anschluss (Zubehör PVG01 [4]) 2x USB 3.2 Gen 2 Typ A (Rot) 2x USB 3.2 Gen 1 Typ A (Blau) 2x Gigabit LAN (RJ45) 2x RS232 serieller Port, 9-pol. D-Sub (5/12V, 1x RS422/RS485) [3] 1x DC-Eingang für externes Netzteil (unterstützt 19V±5%) 1x 4-Pin-Anschluss (2,54 mm Rastermaß) unterstützt: - externen Einschalt-Taster - Clear CMOS Funktion - 5V DC Spannung für externe Komponenten 2x Perforation für optionale Wireless-LAN-Antennen 2x Öffnung für Kensington Lock
WEITERE ONBOARD- ANSCHLÜSSE	1x Jumper für Power-On-after-Power-Fail (Hardware-Lösung) [7] 1x analoger VGA Grafikausgang CN6 (2x10 Pins, 1 mm Pitch) [4] 2x serielle Schnittstelle (COM) belegt für Backpanel-Anschlüsse 1x USB 2.0 (4 Pins) für optionales Zubehör WWN03 (LTE-Kit) 1x Lüfteranschluss (4 Pins) belegt durch das Kühlsystem 1x Anschluss für CMOS-Batterie (belegt)
LIEFERUMFANG	Mehrsprachige Installationsanleitung (DE, EN, FR, ES, JP, KR, SC, TC) VESA-Halterung für 75/100mm-Standard (zwei Metallwinkel) Vier Schrauben M3 x 5 mm (verbindet VESA-Halter mit PC) Vier Schrauben M4 x 10 mm (verbindet VESA-Halter mit externer Befestigung) Vier Schrauben M3 x 4 mm (zur Montage eines 2,5"-Laufwerks) Zwei Schrauben M3 x 5 mm (silberfarben, zum Befestigen von zwei M.2-Karten) Treiber-DVD (Windows 64 Bit) Serial-ATA-Kabel für 2,5"-Laufwerk mit Stromanschluss Externes 90W-Netzteil mit Netzanschlusskabel Schutzkappe für den CPU-Sockel (nicht verwenden, falls Heatpipe oder Kühler installiert sind) Wärmeleitpaste
OPTIONALES ZUBEHÖR	PVG01: Optionaler D-Sub VGA Video-Ausgang [4] WLN-M, WLN-M1: WLAN-Modul im M.2-2230-Format mit zwei externen Antennen unterstützt WLAN und Bluetooth WWN03: LTE-Adapter-Kit mit Antennen, jedoch ohne LTE-Karte [8] PS02: Standfüße für den vertikalen Betrieb CXP01: Adapterkabel für einen externen Power-Button PRM01: 2HE-Rackblende für zwei Shuttle XPC slim PCs DIR01: Hutschienen-Montage-Kit
UMGEBUNGS- PARAMETER	Zulässiger Betriebstemperaturbereich: 0-50 °C [6] Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 10-90 %
ZERTIFIKATE / KONFORMITÄT	EMI: FCC, CE, UKCA, BSMI, RCM, VCCI Sicherheit: CB 60950/62368, cTUVus, BSMI Weitere: RoHS, Energy Star, ErP
KONFORMITÄT	Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) (2) Richtlinie 2014/35/EU über die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln (LVD) (3) Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP)

[1] HDMI-Ausgang unterstützt DVI mit optionalem Adapter

[2] DisplayPort in HDMI/DVI konvertieren

Der DisplayPort Ausgang kann mit einem günstigen, passiven Adapterkabel in HDMI oder DVI konvertiert werden. Zum Beispiel:

DELOCK 82590: 1 m, DisplayPort (männl., 20P) zu HDMI-A (männl., 19P)

DELOCK 82435: 5 m, DisplayPort (männl., 20P) zu DVI-D (männl., 24P)

Die integrierte Grafikfunktion erkennt die Eigenschaft des angeschlossenen Displays und gibt das passende elektrische Signal aus - entweder DisplayPort (ohne Adapter) oder HDMI/DVI (mit Adapter).

Umgekehrt kann ein Bildschirm mit DisplayPort nicht über einen einfachen, passiven Adapter an den HDMI-Ausgang angeschlossen werden.

[3] Serielle Schnittstellen

Dieser PC verfügt über zwei serielle RS232 Schnittstellen mit 9-poligen D-Sub-Anschlüssen auf der Rückseite. Der linke COM-Port (COM1) kann im BIOS-Setup auch auf RS422- und RS485-Modus umgeschaltet werden.

Pin 9 der D-Sub COM-Port-Anschlüsse ist ein multifunktionaler Anschluss. Mit dem Mainboard-Jumper JP1 lässt sich konfigurieren, ob Pin 9 als "Ring Indicator" (RI) geschaltet ist oder eine externe Spannungsversorgung von 5V bzw. 12V bietet. Jeder COM-Port ist einzeln konfigurierbar. Der maximale Strom beträgt 500 mA pro Anschluss.

[4] Optionaler D-Sub/VGA-Ausgang

Das Mainboard verfügt über einen analogen Grafikausgang CN6 auf dem Mainboard. Dieser kann über einen optionalen Adapter (PVG01) als 15-poliger D-Sub-Anschluss nach außen geführt werden. Hierbei wird eine serielle Schnittstelle (COM-Port) im Backpanel ersetzt.

[5] Teaming Modus

Mit der Teaming-Funktion lassen sich beide Netzwerk-Schnittstellen zu einem logischen Netzwerkadapter zusammenfassen, der eine Redundanz erlaubt. Der Vorteil davon ist, dass dadurch Load Balancing (Lastausgleich) und Failover (Ausfallsicherung) ermöglicht werden.

Treiber-Download: <https://downloadcenter.intel.com/download/22283/>

[6] Betriebstemperatur

Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40 °C werden SSD-Laufwerke (bis zu 70 °C) und SO-DIMM-Speicher mit erweitertem Temperaturbereich (bis zu 95 °C) empfohlen.

[7] Power-On-after-Power-Fail

Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich die Funktion "Power-On-after-Power-Fail", womit definiert wird wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen oder (3) ausgeschaltet lassen. Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass das DH470C zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper JP2 (auf dem Mainboard hinter dem Einschalt-Button), dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.

[8] Optionales Zubehör WWN03 (LTE-Kit)

Mit Hilfe des Shuttle XPC accessory WWN03 Zubehör-Kits können Sie diesen PC mit einer LTE/4G-Funktion für mobiles Netzwerk ausstatten. Hierbei wird der 2,5"-Schacht für den Einbau der LTE-Karte belegt, so dass als Massenspeicher eine SSD im M.2-Format notwendig ist. Ein LTE-Modul im M.2-3042-Format und eine Nano-SIM-Karte sind weiterhin erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

[9] Blu-ray-Wiedergabe nur mit entsprechender Software und einem externen Blu-ray-Laufwerk möglich (nicht im Lieferumfang).

[10] Nicht kompatibel sind Intel Prozessoren ohne integrierte Grafikfunktion erkennbar an dem Buchstaben "F" in der Prozessorbezeichnung, z.B. Core i7-10700F.

[11] TPM-Funktion

Dieses Produkt verfügt bereits über ein Firmware-TPM (fTPM) v2.0. Es ist außerdem für einen Hardware-TPM-Chip vorbereitet, so dass es auf Sonderbestellung im Werk bestückt werden kann.

10. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Sockel LGA1200 14nm "Comet Lake S" und "Comet Lake Refresh" Prozessorübersicht (Datum: August 2021)

Prozessoren mit TDP>65 W und Prozessoren ohne Grafikfunktion ("F"-Kennung) werden **nicht unterstützt (rot hinterlegt)**

PROZESSOR	MODELL	CORES/ THREADS	CPU CLOCK	TURBO BOOST 2.0	SMART CACHE	TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION
Core™ i9	10900K	10/20	3,7 GHz	5,1 GHz	20 MB	125 W	DDR4-2933	UHD 630
	10900KF	10/20	3,7 GHz	5,1 GHz	20 MB	125 W	DDR4-2933	Nicht vorhanden
	10900	10/20	2,8 GHz	5,0 GHz	20 MB	65 W	DDR4-2933	UHD 630
	10900F	10/20	2,8 GHz	5,0 GHz	20 MB	65 W	DDR4-2933	Nicht vorhanden
	10900T	10/20	1,9 GHz	4,5 GHz	20 MB	35 W	DDR4-2933	UHD 630
	10850K	10/20	3,6 GHz	5,0 GHz	20 MB	125 W	DDR4-2933	UHD 630
Core™ i7	10700K	8/16	3,8 GHz	5,0 GHz	16 MB	125 W	DDR4-2933	UHD 630
	10700KF	8/16	3,8 GHz	5,0 GHz	16 MB	125 W	DDR4-2933	Nicht vorhanden
	10700	8/16	2,9 GHz	4,7 GHz	16 MB	65 W	DDR4-2933	UHD 630
	10700F	8/16	2,9 GHz	4,7 GHz	16 MB	65 W	DDR4-2933	Nicht vorhanden
	10700T	8/16	2,0 GHz	4,4 GHz	16 MB	35 W	DDR4-2933	UHD 630
Core™ i5	10600K	6/12	4,1 GHz	4,8 GHz	12 MB	125 W	DDR4-2666	UHD 630
	10600KF	6/12	4,1 GHz	4,8 GHz	12 MB	125 W	DDR4-2666	Nicht vorhanden
	10600	6/12	3,3 GHz	4,8 GHz	12 MB	65 W	DDR4-2666	UHD 630
	10600T	6/12	2,4 GHz	4,0 GHz	12 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 630
	10500	6/12	3,1 GHz	4,5 GHz	12 MB	65 W	DDR4-2666	UHD 630
	10500T	6/12	2,3 GHz	3,8 GHz	12 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 630
	10400	6/12	2,9 GHz	4,3 GHz	12 MB	65 W	DDR4-2666	UHD 630
	10400F	6/12	2,9 GHz	4,3 GHz	12 MB	65 W	DDR4-2666	Nicht vorhanden
	10400T	6/12	2,0 GHz	3,6 GHz	12 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 630
Core™ i3	10325	4/8	3,9 GHz	4,7 GHz	8 MB	65 W	DDR4-2666	UHD 630
	10320	4/8	3,8 GHz	4,6 GHz	8 MB	65 W	DDR4-2666	UHD 630
	10305	4/8	3,8 GHz	4,5 GHz	8 MB	65 W	DDR4-2666	UHD 630
	10305T	4/8	3,8 GHz	4,5 GHz	8 MB	65 W	DDR4-2666	UHD 630
	10300	4/8	3,7 GHz	4,4 GHz	8 MB	65 W	DDR4-2666	UHD 630
	10300T	4/8	3,0 GHz	3,9 GHz	8 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 630
	10105F	4/8	3,7 GHz	4,4 GHz	6 MB	65 W	DDR4-2666	Nicht vorhanden
	10105	4/8	3,7 GHz	4,4 GHz	6 MB	65 W	DDR4-2666	UHD 630
	10105T	4/8	3,0 GHz	3,9 GHz	6 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 630
	10100	4/8	3,6 GHz	4,3 GHz	6 MB	65 W	DDR4-2666	UHD 630
	10100F	4/8	3,6 GHz	4,3 GHz	6 MB	65 W	DDR4-2666	Nicht vorhanden
Pentium® Gold	10100T	4/8	3,0 GHz	3,8 GHz	6 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 630
	G6605	2/4	4,3 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	UHD 630
	G6600	2/4	4,2 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	UHD 630
	G6505	2/4	4,2 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	UHD 630
	G6500	2/4	4,1 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	UHD 630
	G6500T	2/4	3,5 GHz	–	4 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 630
	G6405	2/4	4,1 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	UHD 610
	G6405T	2/4	3,5 GHz	–	4 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 610
	G6400	2/4	4,0 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	UHD 610
	G6400T	2/4	3,4 GHz	–	4 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 610

PROZESSOR	MODELL	CORES/ THREADS	CPU CLOCK	TURBO BOOST 2.0	SMART CACHE	TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION
Celeron®	G5925	2/2	3,6 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	UHD 610
	G5920	2/2	3,5 GHz	–	2 MB	58 W	DDR4-2666	UHD 610
	G5905	2/2	3,5 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	UHD 610
	G5905T	2/2	3,3 GHz	–	4 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 610
	G5900	2/2	3,4 GHz	–	2 MB	58 W	DDR4-2666	UHD 610
	G5900T	2/2	3,2 GHz	–	2 MB	35 W	DDR4-2666	UHD 610

K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, **T** = stromsparend, **F** = ohne integrierte Grafikkarte, **TDP** = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).

Hinweis: Das Shuttle XPC slim Barebone DH470C unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie. Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.